

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<p>国信证券一叶子</p> 国信证券股份有限公司—连欣然、胡慧、连欣然 华泰证券—郭春杏、张宇、林文富 光大保德信基金管理有限公司—杨一飞、魏晓雪 光大证券股份有限公司—韩冰 建信理财有限责任公司—付嘉禾、张婧 九泰基金管理有限公司—谭邵杰、赵万隆 天弘基金管理有限公司—张磊、洪明华 长城证券股份有限公司—蒋雨薇 中泰证券—王芳、游凡 Brilliance Asset Management Limited—唐毅 Hel Ved Capital Management Limited—Daniel Guo Pleiad Investment Advisors Limited—Simon Sun 北京高信百诺投资管理有限公司—闫树仁 北京市星石投资管理有限公司—杨英 北京远惟投资管理有限公司—王晨昭 博时基金管理有限公司—廖常青 渤海人寿保险股份有限公司—刘冬 淡水泉（北京）投资管理有限公司—任宇 东吴基金管理有限公司—张浩佳 富安达基金管理有限公司—朱义 富国基金管理有限公司—李娜 富荣基金—毛运宏 高毅—赵浩 光大理财—王连训 广发基金管理有限公司—李骁 国投瑞银基金管理有限公司—陈郑宇 杭银理财—薛翔 恒大人寿保险有限公司—魏大千 华宝基金管理有限公司—吴心怡 华泰资产管理有限公司—郑金镇 华夏基金管理有限公司—赵芷煜 华夏未来资本管理有限公司—丁鑫 嘉实基金管理有限公司—谢泽林

晋江市晨翰私募基金管理有限公司—邱仔强
 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司—董博
 南方基金—吴凡
 宁泉资产—张斌
 宁银理财有限责任公司—韦婉
 鹏华基金管理有限公司—杨飞
 睿亿—陈凯峰
 上海煜德投资管理中心（有限合伙）—王秀平
 上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）—陈俊
 深圳财沣投资有限公司—吕喆
 盛钧投资—童胜
 太平资产管理有限公司—马姣
 天治基金管理有限公司—王倩蓉
 万家基金管理有限公司—周实
 易方达基金管理有限公司—田佳
 银华基金管理股份有限公司—马慧伶
 圆信永丰基金管理有限公司—王海涛
 长安基金管理有限公司—刘嘉
 长盛基金管理有限公司—侯智中
 招商基金管理有限公司—朱之光
 招商证券资产管理有限公司—吴彤
 浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）—常晟
 浙商基金管理有限公司—王斌
 中国人保资产管理有限公司—聂曙光
 中国人寿资产管理有限公司—李晓光
 中海基金管理有限公司—谈必成
 中欧基金管理有限公司—张杰
 中信建投证券股份有限公司—徐博
 中银基金管理有限公司—赵建忠

中信建投—秦基粟

博时基金管理有限公司—曹芮、廖常青、万丽
 中信建投证券股份有限公司—曹世凯、薛林立
 Franklin Templeton SinoAm Securities Investment
 Management Inc—陈宏毅
 淡水泉（北京）投资管理有限公司—林盛蓝
 富荣基金管理有限公司—郎骋成
 光大证券股份有限公司—肖意生
 国泰基金管理有限公司—陈凌暉
 海富通基金管理有限公司—刘海啸
 红杉资本股权投资管理（天津）有限公司—闫慧辰
 宁银理财有限责任公司—黄贤昭
 厦门中略投资管理有限公司—姚迪
 上海光大证券资产管理有限公司—张茂鑫
 上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—刘金磊
 上海聆泽投资管理有限公司—徐亦昊

	上海彤泰私募基金管理有限公司—曹剑飞 上海肇万资产管理有限公司—高文丽 申万宏源投资有限公司—屈玲玉 深圳多鑫投资管理有限公司—成佩剑 太平资产管理有限公司—窦萍华 万和证券股份有限公司—赵维卿 西部利得基金管理有限公司—梁晓明 中汇人寿保险股份有限公司—梁红云 中信建投经管委财富管理部客户—李啸骏 高毅资产—邓晓峰 朱春禹 罗晓迪 华泰证券—张宇 郭春杏 易方达—倪春尧 邓佳琦 李凌霄 陈广 华安基金—许瀚天 胡哲 信达澳亚—朱然 童昌希 刘权 罗晨熙
会议时间	2024 年 4 月 25 日 09: 00—10: 00 (国信证券) 2024 年 4 月 25 日 15: 00—16: 00 (中信建投) 2024 年 4 月 26 日 10: 00—11: 00 (高毅资产) 2024 年 4 月 26 日 14: 00—15: 00 (易方达) 2024 年 4 月 29 日 09: 45—10: 30 (华安基金) 2024 年 4 月 29 日 14: 00—15: 00 (信达澳亚)
地点	江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号行政楼 4 楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：张家铨先生，公司董秘办主任、证券事务代表：沈志鹏先生，公司证券事务与投资者关系管理专员：朱天娇女士、虞晶晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="color: red;">一、公司副总经理、董事会秘书张家铨先生介绍公司概况和2024年第一季度报告营收情况。</p> <p>各位投资者好！欢迎大家参加此次的调研活动。</p> <p>公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的业务体系，业务模式以IDM模式为主。公司是集功率半导体器件、功率集成电路、新型元件的芯片研发和制造、器件研发</p>

和封测、芯片及器件销售和服务为一体的功率（电力）半导体器件制造商和品牌运营商。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，分别为：晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片Y电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及组件、碳化硅器件等。公司晶闸管系列产品、二极管及防护系列产品采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，即集功率半导体芯片设计、制造、器件设计、封装、测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体。公司MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品委外流片相结合的业务模式，目前，部分8英寸芯片为委外流片，部分器件封测代工。

2024年一季报报告期内，经营业绩如下：公司实现营业收入51,954.44万元，较上年同期增长28.80%；营业利润11,179.58万元，同比增加282.91%；利润总额11,160.27万元，同比增加287.93%；净利润9,430.78万元，同比增加289.11%；归属于上市公司股东的净利润9,195.05万元，去年同期3,176.10万元，同比增加189.51%。基本每股收益0.13元，去年同期0.04元，同比增加225.00%。

报告期末，公司总资产为770,442.52万元，同比减少-1.31%；股本为73,632.14万元；所有者权益为449,142.52万元，同比增长2.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为385,126.23万元，同比增长6.53%。

二、主要交流问题

1、公司2024年第一季度晶闸管、防护器件和MOS的营收情况？

答：在客户端的关心与支持下，在全体员工的共同努力下，公司晶闸管（芯片+器件）营业收入1.17亿，较上一年度同比增加52.16%，占公司2024年一季度主营业务收入的22.69%；公司防护器件（芯片+器件）营业收入1.68亿，较上一年度同比增加

26.23%，占公司2024年一季度主营业务收入的32.69%；公司MOSFET（芯片+器件）营业收入2.29亿，较上一年度同比增加18.62%，占公司2024年一季度主营业务收入的44.62%。谢谢！

2、公司2024年第一季度晶闸管、防护器件和MOSFET的毛利率情况？

答：2024年第一季度公司晶闸管（芯片+器件）毛利率为49.51%；公司防护器件（芯片+器件）毛利率为34.82%；公司MOSFET（芯片+器件）毛利率为33.62%。谢谢！

3、公司一季度营收情况同比去年增幅较大，请问是什么原因？

答：上年一季度消费类电子行业的景气度不是很好，公司下游领域中消费类电子占比依旧很高。随着今年各行各业在慢慢回暖，下游领域也在慢慢复苏，公司各产品线的销售都有一定的增幅。因此公司一季度营收情况同比去年增幅较大。谢谢！

4、请问公司各产品今年以来的价格是否有变化？

答：公司的主营产品为各类电力电子器件和芯片，如晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、MOSFET器件和芯片、碳化硅器件等。其中晶闸管产品的目前价格趋于稳定；防护器件目前价格较平稳，市场依旧竞争激烈；MOSFET在2024年竞争非常激烈，依然有向下的可能。相信未来价格将逐步平稳，但短期还会在低位运行。谢谢！

5、请问MOSFET目前的业务模式是怎么样的？

答：公司的MOSFET采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式和部分产品的委外流片相结合的业务模式。公司部分产品的芯片委托芯片代工厂进行芯片制造，芯片一部分用于公司自主封装，另一部分委托外部封测厂进行封测。除部分产品的芯片制造由代工厂代工生产外，公司MOSFET产品与晶闸管和防护器件产品生产模式一致。公司的“高端功率半导体器件产业化项目”及功率半导体“车规级”封测产业化项目也有助于推动高端功率半导体

发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，将进一步提升公司市场竞争力、综合实力与治理能力，完善公司战略布局。谢谢！

6、捷捷微电(南通)科技有限公司一季度已经盈利，请问该子公司目前的产能如何？

答：由捷捷微电(南通)科技有限公司承建的“高端功率半导体器件产业化项目”建设用地位于南通市苏锡通科技产业园区井冈山路1号，南通“高端功率半导体器件产业化项目”该项目自2022年9月下旬起进入试生产阶段，试生产的产品良率符合预期，基本保持在95%以上。公司结合市场情况，目前该项目每月产能约为10万片左右，该项目仍处在产能爬坡期。该项目将有助于推动高端功率半导体发展，满足下游市场需求，扩大市场占有率，缓解MOSFET产能紧张的问题等，将进一步提升公司市场竞争力、综合实力与治理能力，完善公司核心“功率半导体器件IDM”供应链的战略布局。谢谢！

7、请问公司下游领域占比？未来重点的发展方向是什么？

答：公司的下游客户分布十分广泛，客户众多。按照产品的应用领域的不同，大致分为这几个类别：工业（安防、低压电器、电力模块、电力仪表、电源电机、光伏储能等）、汽车电子、通信、消费（电源管理、家电、照明、智能终端等）。占比情况为工业 40%；消费领域 36%；汽车 18%；通信 3%。未来公司将重点拓展三大市场：汽车电子、电源类及工业类。在汽车电子领域：主要为各类马达驱动，汽车照明，汽车无线充，汽车锂电池管理等；电源类领域，主要为太阳能光伏，储能，充电桩，及重点大客户功率器件需求等；工业类领域，主要为高功率马达驱动，锂电池管理，逆变器，压缩机等。谢谢！

8、公司第三代半导体进展情况如何？

答：公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，截至2024年第一季度末，公司拥有氮化镓和碳化硅相关实用新型专利6件，发明专利1件；此外，公司还有10个发明专利尚在申请受理

	<p>中。公司目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中，尚未进入量产阶段。关于碳化硅器件和氮化镓器件，衬底材料决定了产品的成本在短期内很难降下来，此外还有产品良率等因素，决定了碳化硅、氮化镓器件目前只能适合高端应用。这是功率半导体器件未来发展之必然。我们有耐心做好技术和人才的准备，后续进展情况，请继续关注公司的相关公告。谢谢！</p> <p style="text-align: center;">9、公司是否会提升海外市场的销售？</p> <p>答：公司为实现半导体分立器件国产替代化的进程而努力着，海外销售的占比一般占年总营收的15%左右；全球营销中心的海外团队在新加坡，随着海外市场的逐渐扩大，公司也会继续加大在海外市场的业务布局，并根据业务发展需要持续引进优秀人才。谢谢！</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p>日期</p>	<p style="text-align: center;">2024-4-30</p>